



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080814002B
2011 年 4 月 12 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

SOIC 8/14Dパッケージ一部製品 組立サイト追加変更のご案内
(認定済 53 製品への追加認定 2 製品の連絡)

(第二版 PCN20080814002A 2008 年 9 月 29 日発行, 初版 PCN20080814002 2008 年 8 月 27 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	下記変更について認定済 53 製品への追加認定 2 製品の連絡になります。 SOIC 8/14D パッケージ一部製品 組立サイト追加変更 現行 : TI-Taiwan(台湾) 変更後: TI-Taiwan(台湾), TI-Mexico(メキシコ)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は 7 月下旬の出荷より予定しています。 認定終了品は 2009 年 1 月上旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更について認定済 53 製品への追加認定 2 製品の連絡になります。
 弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) SOIC 8/14D パッケージ一部製品について、現行 TI-Taiwan (台湾) サイトにて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Mexico (メキシコ) サイトを追加し認定しました。部材の変更は下記の通りになります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立サイト	TI-Taiwan(台湾)	TI-Taiwan(台湾) TI-Mexico(メキシコ)

	現行	追加認定
組立サイト	TI-Taiwan	TI-Mexico
チップ接着剤	4042500	4147858

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
■: 追加認定品 □: 認定終了品				
TLC074CD	TLC274CDG4	TLC27L4CDR	TLC3931DRG4	TLE20721D
TLC074CDG4	TLC274CDR	TLC27L4CDRG4	TLC556CD	TLE20721DG4
TLC074CDR	TLC274CDRG4	TLC3391D	TLC556CDG4	TLE20721DR
TLC074CDRG4	TLC277CDR	TLC3391DG4	TLC556CDR	TLE2141A1DR
TLC2252CDR	TLC277CDRG4	TLC3391DR	TLC556CDRG4	TLE2141A1DRG4
TLC2252CDRG4	TLC27L4ACD	TLC3391DRG4	TLE20271DR	TLE21421DR
TLC22541D	TLC27L4ACDG4	TLC374CD	TLE20271DRG4	TLE21421DRG4
TLC22541DG4	TLC27L4ACDR	TLC374CDG4	TLE20371DR	TLV22521DR
TLC22541DR	TLC27L4ACDRG4	TLC374CDR	TLE20371DRG4	TLV22521DRG4
TLC22541DRG4	TLC27L4CD	TLC374CDRG4	TLE2062A1DR	TLV2462CDR
TLC274CD	TLC27L4CDG4	TLC3931DR	TLE2062A1DRG4	TLV2462CDRG4

製品表示

今回の変更に伴い、製品捺印上にて、サイトコード“S”の記載が“T”(TI-Taiwan)から“M”(TI-Mexico)に変更されます。

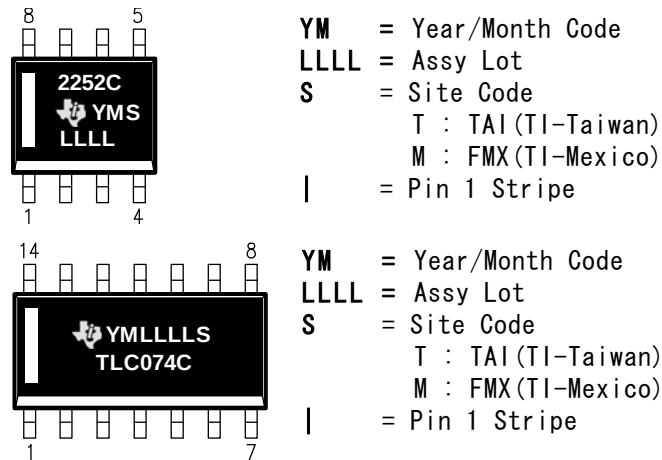


図 1 製品捺印の表示例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	-	終了	2008 年 6 月 23 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TLC274CDR			TLV2462CD
Die Rev/ Size(mils):	F / 109.0 X 69.0			A / 49.0 X 49.0
Wafer Fab Site:	DFAB			DFAB
Technology/ Fab Process:	CMOS / LinCMOS_5/5			BiCMOS / LBC3S
Assembly Site:	FMX			FMX
Package/ Pins:	D / 14			D / 8
Mold Compound:	4205694			4205694
Mount Compound:	4147858			4147858
Bond:	TS-0.95Au			TS-0.95Au
L/F Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu			Cu / NiPdAu
MSL:	JEDEC L-1/260C			JEDEC L-1/260C
Flammability Rating:	UL 94 V 0			UL 94 V 0
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		TLC274CDR	TLV2462CD	
Manufacturability	Per site spec	Approved	Approved	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	-	終了	2004 年 6 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN74HC4060D			TL598CD
Die Rev/ Size(mils):	G / -			F / 80.0 x 80.0
Wafer Fab Site:	SHE			SHE
Technology/ Fab Process:	CMOS / HCMOS			Bipolar / JI Bipolar
Metal1-2:	TiW/AICu2%			TiW/AICu2%
Passivation:	10KACN			10KACN
Assembly Site:	FMX			FMX
Package/ Pins:	D / 16			D / 16
Mold Compound:	4205694			4205694
Mount Compound:	4147858			4147858
Bond:	TS-0.95Au			TS-0.95Au
L/F Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu			Cu / NiPdAu
MSL:	JEDEC L-1/260C			JEDEC L-1/260C
Flammability Rating:	UL 94 V 0			UL 94 V 0
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		SN74HC4060D	TL598CD	
**Steady-state Life Test	150C, 300 hrs	120/0	120/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 hrs	78/0	78/0	
**Autoclave	121C, 96 hrs	231/0	231/0	
**Temperature Cycle	-65/150, 1000 cyc	231/0	231/0	
**Thermal Shock	-65/150, 1000 cyc	231/0	231/0	
**Storage Bake	170C, 420 hrs	231/0	231/0	
Lead Pull to Destruction	Per MFG spec	66/0	66/0	
Flammability	UL 94V-0	15/0	15/0	
	UL-1694	15/0	15/0	
	IEC 695-2-2	15/0	15/0	
X-RAY	Top side, per mfg spec	15/0	15/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC Level -1/260C	12/0	12/0	
Note: ** Preconditioning Sequence, JEDEC L-1/260C				